

金居（8358）查證報告：台灣HVLP4電解銅箔龍頭，卡位AI伺服器材料供應鏈

使用者點播主題 · 2026-09-07 產出 · 原始點播：金居

金居開發（8358，上櫃）是台灣主要的電子級電解銅箔廠，主力產品從標準銅箔升級到超低粗糙度的HVLP4系列，已通過Intel、AMD、NVIDIA三大平台認證，供應NVIDIA H100、GB200等AI伺服器用高速CCL/PCB的上游銅箔原料。2025年營收與獲利明顯成長，2026年上半年持續放量，但股價已反映高成長預期、估值偏貴，且面臨銅價原物料波動、日系大廠與國內同業競爭、AI資本支出週期等風險。

公司定位：電子級電解銅箔廠，非PCB或封裝廠

金居開發主要經營業務為電子零組件製造業、金屬表面處理業與鍊銅業，核心產品是印刷電路板（PCB）與銅箔基板（CCL）上游最關鍵的原料之一——電子級電解銅箔，銷售對象是台燿、聯茂、南亞塑膠、金像電等CCL／PCB廠，而不是直接做PCB或封裝的公司。這點在股票名稱歸類時容易被誤認成PCB廠或封裝廠，需特別區分：金居本身不生產PCB成品，是往上游一層的銅箔材料供應商。

技術升級與AI伺服器材料角色

金居近年產品組合從標準銅箔逐步轉向超低粗糙度的HVLP3／HVLP4系列，主打訊號傳輸損耗低、適合高速數位訊號應用。HVLP系列已通過Intel、AMD、NVIDIA三大平台認證，用於NVIDIA H100及新一代GB200、B200等AI伺服器主機板/交換器板高速CCL的銅箔材料，是市場將其列入「AI伺服器供應鏈」概念股的主要原因。（推論）這代表金居的營收成長與AI伺服器資本支出、CoWoS/高速運算需求連動性較高，但金居本身並非直接的AI晶片或伺服器組裝廠。

財務與產能

依查證資料，2025年合併營收約78.80億元，全年EPS 4.21元（年增約46%）；2026年第1季EPS 2.06元（年增約96%、季增約37%），單季毛利率28.71%、營業利益率25.63%、淨利率20.52%；2026年1-4月累計營收34.33億元（年增約43.56%）。產能方面，HVLP3／HVLP4合計月產能原約100噸，計畫在2026年下半年擴充至約150噸（增幅約50%），高階產品占營收比重約15%至20%。以上數字為公開報導與財經資料網站彙整所述，未經本站另行核對財報原文，供參考。

相關個股

- **8358 金居** — 台灣主要電子級電解銅箔廠，HVLP3/HVLP4通過Intel、AMD、NVIDIA認證，供應AI伺服器用高速CCL/PCB上游銅箔原料（查證來源：風傳媒、口袋學堂、財報狗）

風險與觀察重點

查證到的主要風險：(1) 估值偏高——報導指出滾動本益比約90倍、股價淨值比約14-17倍，若2026全年EPS未能達到市場預期（約10元），本益比有壓縮空間；(2) 原物料成本風險——陰極銅、金、硫酸等原料價格波動直接影響毛利率；(3) 競爭風險——日系大廠（古河電工、三井金屬）若擴產，或國內同業（如南亞塑膠銅箔事業）搶單，可能壓縮金居的高階銅箔議價空間；(4) 訂單集中度／景氣循環風險——高階HVLP訂單高度綁定NVIDIA GB200等特定AI伺服器平台出貨節奏，若2026下半年美系雲端業者（CSP）資本支出放緩或GB200出貨遞延，訂單能見度會立即受影響。以上為報導整理，非本站獨立驗證的財務數字。

查證來源（本報告依站內規則，沒有外部來源就不產出）：<https://www.storm.mg/article/11064983> · <https://www.pocket.tw/school/report/SCHOOL/7495/> · <https://www.pocket.tw/school/report/SCHOOL/5966/> · <https://statementdog.com/analysis/8358> · <https://www.cnyes.com/twstock/8358>

本報告為系統依使用者點播主題自動整理之資訊，明確標示「（推論）」者為推論而非查證事實；僅供研究參考，不構成投資建議。